

電子機器向け熱対策

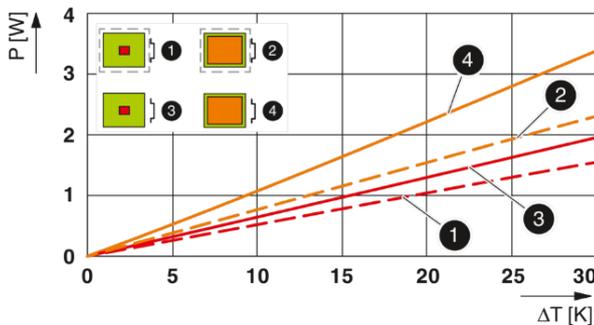
電子機器の高性能化や小型化に伴い、電力密度が高まり、機器の熱対策は重要な課題となっています。フエニックス・コンタクトでは機器全体の熱対策をサポートするために熱シミュレーションを実施し、結果を基に基板レイアウトの変更やヒートシンクの追加など、適切なアドバイスを提供します。



特長

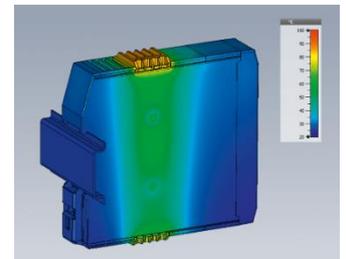
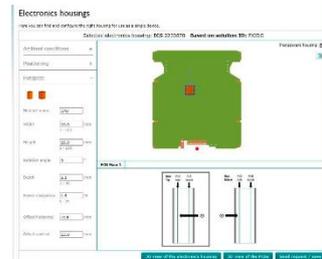
① ディレーティング図と電力損失の想定

ケースサイズと熱源の大きさから放熱可能な最大消費電力を読み取ることが可能です。これにより、設計初期段階でヒートシンクなどの特別な熱対策が必要か想定することができます。



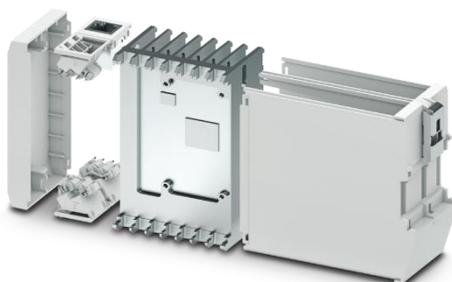
② オンライン熱シミュレーション

一部の製品シリーズでは、コンフィグレータによるケース構成の決定後、熱源のサイズや配置、消費電力などの情報を設定し、オンライン上で当社へ熱シミュレーションの依頼が可能です。これにより最適な基板レイアウトの検討やヒートシンクの有無による放熱の効果を確認可能です。



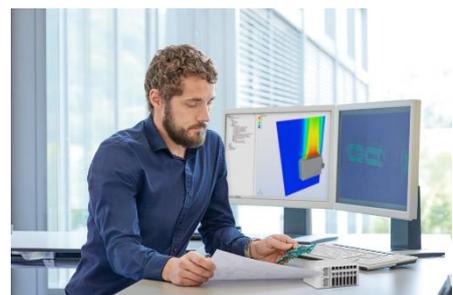
③ カスタマイズ可能なヒートシンク

当社の専用ヒートシンクは、お客様のご要望に応じて、部品接触面に後加工を加えることが可能です。これにより、高さの異なる熱源部品に対しても1つのヒートシンクで熱対策が可能です。



④ 熱対策に関する総合的なアドバイス

プリント基板の初期設計のアドバイスや、熱伝導材(TIM)の推奨品の提案、実装部品に合わせたヒートシンクの調整など総合的なアドバイスによりお客様の機器の熱対策をサポートします。



● オンラインコンフィグレータ

当社WEBページからオンライン上で製品シリーズやコネクタ・端子台、各種アクセサリ類の選定や、選定した部品の構成に合わせた推奨基板形状の確認が可能です。

さらに一部の製品シリーズでは熱シミュレーションの依頼も可能です。

オンラインコンフィグレータこちら

下図赤枠の検索窓にWEBコード「#0512」と入力いただくことでもアクセス可能です。



ホーム > 製品概要 > 電子機器用ケース > 電子機器用ケース

電子機器用ケースのコンフィグレータ

ソリューションIDを読み込む

ハウジングの寸法	▼
接続方式	▼
温度データ	▼

ICS シリーズ

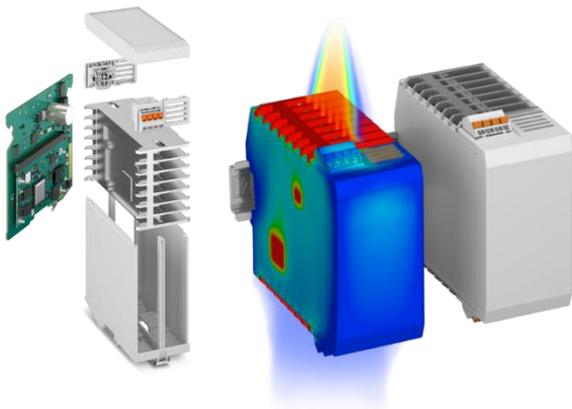
さまざまな接続テクノロジーから選択可能なモジュール型ケースシステム ICSシリーズ

NEW with Thermal Simulation

● ヒートシンク製品ラインアップ

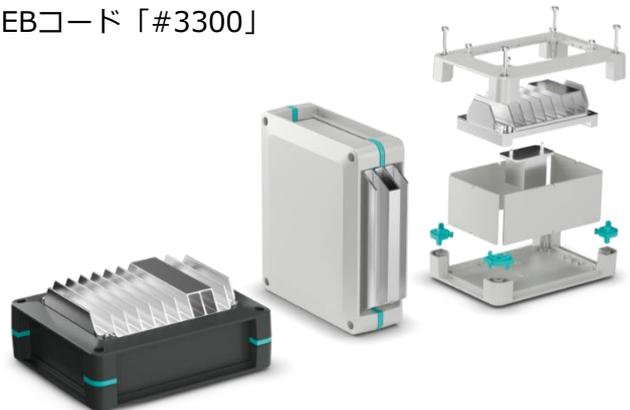
ICSシリーズ **製品リストはこちら**

WEBコード「#2323」



UCSシリーズ **製品リストはこちら**

WEBコード「#3300」



仕様などの記載内容は、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

フェニックス・コンタクト株式会社

本社 〒222-0033 横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

東京支店 03-6712-3088	さいたま支店 048-631-3371
東北支店 022-226-8890	北陸支店 076-210-4360
静岡支店 054-202-6324	名古屋支店 052-589-3810
大阪支店 06-6350-2722	京都支店 075-325-5990
広島支店 082-568-1664	福岡支店 092-418-2030

www.phoenixcontact.co.jp

